(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2005 年11 月10 日 (10.11.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/106945 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/68, 21/301, 21/52

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/007954

(22) 国際出願日: 2005 年4 月27 日 (27.04.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-133069 2004 年4 月28 日 (28.04.2004) JP
特願2004-155596 2004 年5 月26 日 (26.05.2004) JP
特願2004-355312 2004 年12 月8 日 (08.12.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 辻本正樹 (TSUJIMOTO, Masaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 吉岡孝久 (YOSHIOKA, Takahisa) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小林賢治 (KOBAYASHI, Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

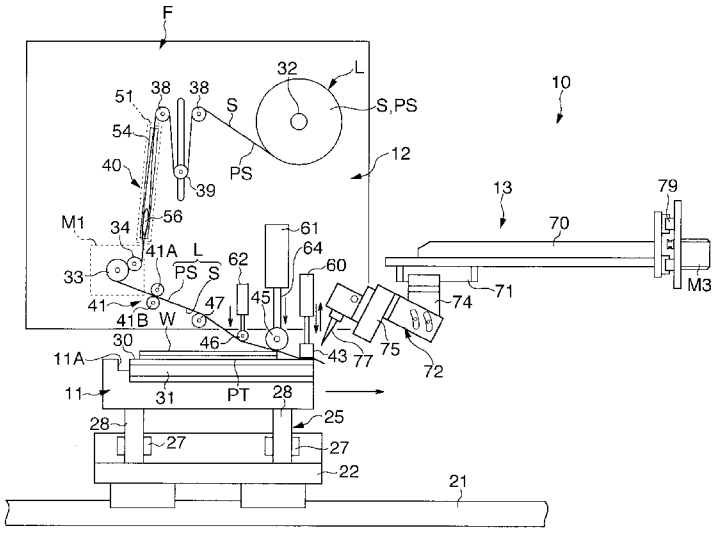
(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

[続葉有]

(54) Title: ADHERING APPARATUS AND ADHERING METHOD

(54) 発明の名称: 貼付装置及び貼付方法



(57) Abstract: An adhering apparatus (10) is provided with an adhering table (11) for supporting a semiconductor wafer (W), and an adhering unit (12) for adhering an adhesive sheet (S), which has heat-sensitive adhesiveness, on the semiconductor wafer (W). The adhering unit (12) includes a peeling part, which peels a peeling sheet (PS) from the adhesive sheet (S) at the time of unrolling a whole cloth (L) wherein the adhesive sheet (S) is laminated on one surface of the peeling sheet (PS), and a preliminary sheet peeling apparatus (40) provided in the upstream of the peeling part in the whole cloth unrolling direction. The preliminary sheet peeling apparatus (40) is provided with a moving member (50) which reciprocates by being sandwiched between the peeling sheet (PS) and the adhesive sheet (S). The peeling sheet (PS) preliminarily peeled and the adhesive sheet (S) can be temporarily adhered again by a temporarily re-adhering apparatus (41), and the adhesive sheet (S) can be adhered on the wafer (W).

(57) 要約: 半導体ウエハWを支持する貼付テーブル１１と、半導体ウエハWに感熱接着性の接着シートＳを貼付する貼付ユニット１２とを備えて貼付装置１０が構成されている。貼付ユニット１２は、剥離シートＰＳの一方の面に接着シートＳが積層された原反Ｌを繰り出す際に剥離シートＰＳと接着シートＳとを剥離する剥離部と、当該剥離部よりも原反繰出方向上流側に設け

[続葉有]

WO 2005/106945 A1

BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

られたシート予備剥離装置４０とを含む。シート予備剥離装置４０は、剥離シートＰＳと接着シートＳとの間に挟まれた状態で往復移動する移動部材５０を備えて構成されている。また、予備剥離された剥離シートＰＳと接着シートＳは、再仮着装置４１によって再仮着して接着シートＳをウエハWに貼付することもできる。